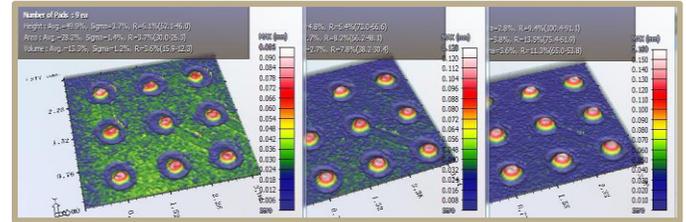


J8 SOLDADURA EN PASTA NO CLEAN PARA DISPENSADO

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de depósitos de 200µm
- Menor área de huecos: <5% en BGA y <10% en componentes BTC
- Elimina defectos HiP
- Cumple con la norma REACH y RoHS*
- Efectiva acción de mojado (humectación) en superficies con acabado libre de plomo
- Pasa la prueba Bono
- Disponible en aleaciones SAC305 y Sn63



DESCRIPCIÓN

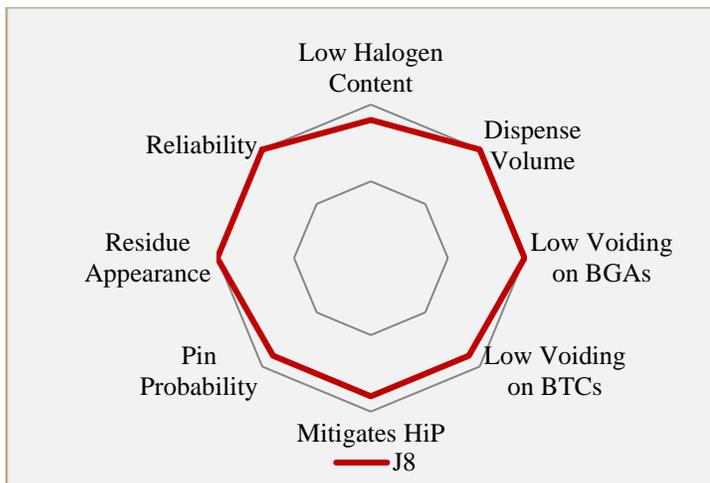
La soldadura en pasta no clean de dispensado, J8 de AIM, está especialmente formulada para su uso con equipos de dispensado que proporcionan depósitos de soldadura consistentes tan pequeños como 200µm. J8 es totalmente compatible con todas las soldaduras en pasta no clean de AIM, cuando se requiera la combinación de métodos de dispensado por inyección e impresión. Esta soldadura en pasta tiene un novedoso sistema de activación que proporciona una acción de humectación potente y duradera compatible con una amplia gama de perfiles produciendo uniones brillantes sin defectos de reflujo (graping). J8 es capaz de reducir la formación de huecos hasta <5% en BGA y <10% componentes BTC.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

| Parámetro | Tiempo | Temperatura |
|---|---------|----------------------|
| Vida útil de pasta cerrada y refrigerada | 6 meses | 0°C-12°C (32°F-54°F) |
| Vida útil de pasta cerrada no refrigerada | 2 días | < 25°C (< 77°F) |

La pasta J8 se suministra en jeringas EFD Optimum de 5cc. Los barriles se deben almacenar en refrigeración, boquilla abajo y retirarse de la refrigeración 4-6 horas antes del uso. No se debe volver a refrigerar. Después de abrir el contenedor, la vida útil de la pasta va a depender del entorno y de la aplicación. Consulte las instrucciones de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de J8 para información específica del producto.

CARACTERÍSTICAS



*Aleaciones libres de plomo

LIMPIEZA

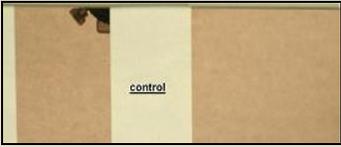
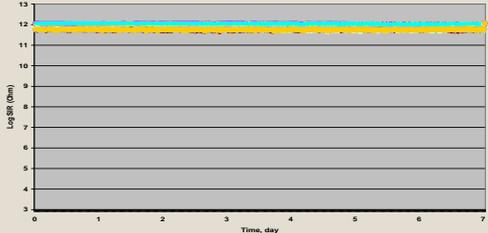
El sistema de inyección debe limpiarse según las instrucciones del fabricante.

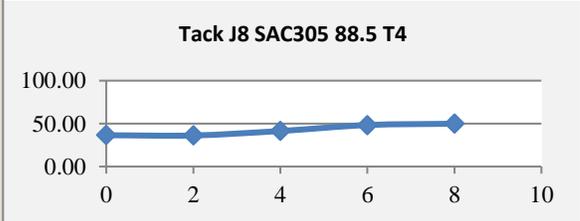
Residuos de flux después del reflujo: Los residuos de J8 pueden permanecer en el ensamble después del reflujo y no requieren limpieza. AIM ha trabajado estrechamente con socios en la industria para asegurar que los residuos J8 se puedan eliminar eficazmente con agentes limpiadores de flux comunes, para cuando la limpieza es obligatoria. Contáctenos para información sobre compatibilidad y limpieza.

PERFIL DE REFLUJO

La información detallada de perfiles se puede encontrar en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Póngase en contacto con AIM para obtener información adicional.

RESUMEN DE DATOS DE PRUEBA

| Nombre | Método de Prueba | Resultados | |
|---|---|--|---|
| Clasificación de flux IPC | J-STD-004 | ROL0 | |
| Clasificación de flux IPC | J-STD-004B 3.3.1 | ROL1 | |
| Nombre | Método de Prueba | Resultados Típicos | Imagen |
| Cobre acabado espejo | J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32 | BAJO |  |
| Corrosión | J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15 | APRUEBA | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ANTES</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>DESPUES</p>  </div> </div> |
| Haluros Cuantitativo | J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1 | Br: 0.24% Cl: 0.0% Típico | |
| Haluros Cualitativo, Cromato de Plata | J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33 | APRUEBA |  |
| Haluros Cualitativo, Prueba de Fluoruro | J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1 | Sin fluoruros | |
| Resistencia al aislamiento superficial | J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7 | Todas las medidas en patrones de prueba exceden 100 MΩ |  |

| Nombre | Método de Prueba | Resultados Típicos | Imagen | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|------------|--------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| Prueba Bono | | Aprueba Fc<8.0 Típico | | | | | | | | | | | | | |
| Prueba de halógeno de la bomba de oxígeno | EN14582:2007 SW 9056 SW 5050 | Br 265 mg/Kg Cl <122 mg/Kg | | | | | | | | | | | | | |
| Migración electroquímica | J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1 | APRUEBA | | | | | | | | | | | | | |
| Sólidos de flux, fracción no volátil | J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34 | 94.77% Típico | | | | | | | | | | | | | |
| Determinación del valor de ácido total | J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13 | 135.95 mgKOH/g flux Típico | | | | | | | | | | | | | |
| Viscosidad | J-STD-004B 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34 | 200-500 Kcps | | | | | | | | | | | | | |
| Visual | J-STD-004B 3.4.2.5 | APRUEBA | | | | | | | | | | | | | |
| Slump | J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35 | APRUEBA | | | | | | | | | | | | | |
| Bola de soldadura | J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43 | APRUEBA | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>15 min</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4 hrs</p>  </div> </div> | | | | | | | | | | | | |
| Adhesividad | J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44 | 36.1 gf Tiempo 0 Típico | <div style="text-align: center;"> <p>Tack J8 SAC305 88.5 T4</p>  <table border="1"> <caption>Tack J8 SAC305 88.5 T4 Data</caption> <thead> <tr> <th>Time (min)</th> <th>Tack Strength (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> </div> | Time (min) | Tack Strength (gf) | 0 | 40 | 2 | 40 | 4 | 45 | 6 | 50 | 8 | 50 |
| Time (min) | Tack Strength (gf) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |